



H2086 双组份光学封装材料

H2086 是专门针对有光学透明、耐候性、低应力要求的封装制程设计的一款双组分、低黏度的环氧浇铸材料。

产品描述

产品特性

条目	描述	备注
技术类型	改性环氧树脂	-
组分	双组分	-
混合比例	A组分: B组分=100: 150	质量比
产品应用	光学元件封装	-

产品优点

- 低粘度;
- 耐候性好;
- 低应力

产品性能

未固化时性能

条目	H2086A	H2086B	备注
外观	黑色透明液体	灰白色液体	-
粘度 cps	150	3000	GB/T 2794 @ 25°C
混合粘度 cps	1000~1500		GB/T 2794 @ 25°C
比重 g/cm ³	1.15	1.20	GB/T 13354 @ 25°C
可操作时间	60 分钟		@ 25°C

固化后性能

在推荐的条件下固化:

条目	典型值
物理性能	硬度 /D
	> 80
	玻璃化转变温度/ °C
	105
	线性热膨胀系数/ppm (< Tg)
	51



	线性热膨胀系数/ppm (> Tg)	173
	线性收缩率/%	0.9
	弯曲强度/ MPa@25°C	143
	弯曲模量/GPa	1.8
	吸水率/ 25°C水中浸泡 24 小时, %	0.3
	介电常数/ 1MHz@25 °C	3.1
	介电损耗因子/ 1MHz@25 °C	0.019

建议固化条件

100°C/60 分钟

操作及注意事项

- (1) A 与 B 剂按 100: 150 重量比准确称重混合, 均匀搅拌 3-5 分钟即可使用。
- (2) 排气脱泡, 建议使用真空气压 0~10mmHg
- (3) 使用时注意避免粘在衣物上, 条件允许请戴手套。
- (4) 材料表面有油污须先清除, 粘接强度才会达到最强。

为防止未使用产品受到污染, 请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息, 请咨询 Hanlicon 应用工程师。有关本产品的安全注意事项, 请查阅安全数据资料。

标准包装

- 支装: 50ml/支
- 桶装: A : 2kg/桶 B: 3kg/桶
- 根据客户要求

产品储存

本产品最佳存储条件: 常温, 阴凉, 避光密封, 存储期 6 个月。

本产品无毒性、无危险性, 遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内, 并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。



注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com